
未來計劃及[編纂]

未來計劃和展望

有關我們未來計劃及策略的詳盡說明，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]

我們估計，在扣除[編纂]、費用及我們就[編纂]應付的估計開支後，假設[編纂]為每股[編纂]，本公司將收到[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元。我們目前擬將該等[編纂]用於以下用途：

- 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）將用於擴充產能。根據弗若斯特沙利文的資料，全球PCB市場預計將從2026年的人民幣6,856億元增長至2030年的人民幣10,880億元。此外，快速增長的高價值行業（如ESS及AI PCB）將成為我們業務（尤其是我們的高性能產品）的另一增長動力。因此，該投資是我們增長策略的核心組成部分，旨在加強我們的後端基礎設施，以支持我們不斷擴大的業務營運增長，確保高質量、高效及合規的生產能力。請參閱「業務－我們的戰略－依託產能擴充與製造升級強化交付能力」。具體而言，
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於購買新生產基地的土地。該基地將作為我們開發及生產高性能電解銅箔產品的主要生產設施。該項採購將確保我們現有生產水平保持競爭力，並能靈活應對不斷演變的市場需求及產品組合的快速調整。該土地收購預計於2027年完成。
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於建設新生產基地。該項計劃重點在於建立生產設施及其他辦公室等配套設施。施工階段主要計劃於2027年及2028年進行，分配比例約為2027年佔[70]%及2028年佔[30]%。
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於採購生產、辦公及其他用途的設備。本公司的新生產基地預期將配備關鍵先進機器。該等實體儀器設備包括銅溶解槽、變壓器、高低壓櫃及其他生產設備，確保生產的高質量、穩定性及成本效益，從而使本公司在多變的市場中維持競爭優勢。具體而言，該採購預算的很大部分（約325.2百萬港元）將分配至關鍵生產機器。這包括約64套製膜機系統，包括陰極輥、轉換器及銅母線，該等設備是我們高性能產品之一超薄鋰電池銅箔生產所需的必要設備。該等設備的採購計劃於2027年開始並持續至2028年，其中約20%（或65.0百萬港元）將分配至2027年，約80%（或260.2百萬港元）將分配至2028年。此外，將建設設備安裝工程、生產線以及高低壓供電，以確保我們的製造業務符合適用法規並履行我們對可持續實踐的承諾。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於銅箔生產廠房初始填充所需的材料。此次初始投料（包括原材料及生產啟動）計劃於2028年開始。

結合對可擴充的實體基礎設施及先進生產機械的投資，旨在打造具備韌性、高效率及面向未來的生產生態系統，從而以穩定、高品質及合規的產出，為我們不斷擴張業務營運提供可靠支撐。新生產基地預期產能為每年約20,000噸高性能電解銅箔產品。擴充產能旨在應對先進銅箔產品（尤其是超薄鋰電池銅箔）需求的預期增長，與我們專注於高性能、高附加值產品以把握高端市場領域增長的戰略一致。我們對市場需求的評估已考慮到AI及高性能算力的指數級增長、5G/6G通信基礎設施的預期普及以及電動汽車的日益普及，該等均需要先進的銅箔解決方案。該等舉措乃戰略性地定位於服務不同的客戶地區及產品領域。由本次[編纂]資助的新生產基地將進一步提升我們的整體產能，以滿足不同地區及應用領域客戶日益增長的需求。

- 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）將用於持續投資於本公司的研發活動，以提升技術水平。該項投資旨在改善本公司的研發能力，以滿足新興行業趨勢及特定客戶需求。請參閱「業務－我們的戰略－持續加強技術研發，提升產品競爭優勢」。具體而言，
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於設立及建設全新的現代化研發中心。設立新的研發中心預期將鞏固及延伸我們的技術領導地位，尤其是在當前下游市場快速演變且具有不同特定需求的情況下，這要求我們開發更先進的技術及產品，並投入更多研發資源。具體撥款主要包括新建研發中心的場地建設。該中心將作為本公司研發運營及創新活動的核心樞紐，配備各類高性能研發實驗室、檢測室及中試生產設施，旨在提升本公司的尖端生產系統並增強市場競爭力。這將涉及約2500平方米的研發設施，建設支出主要計劃於2027年及2028年發生。
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預計用於購置高性能研發硬件設備及配套系統軟件，以推動技術升級與新產品開發。此項投入旨在整合先進設備與精密工程，大幅提升工藝效率、精度與控制水平。具體包括採購：(i)研發及測試設備，例如用於固態電池多金屬負極集流體、電子電路銅箔表面處

未來計劃及[編纂]

理的裝置。該等設備可精確檢測、識別並處理多種材料、化學元素及金屬污染物，助力研發中心開創精密測試方法，提升整體科技實力；及(ii)研發中心相關的辦公設備與電子裝置。

- 。 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預計用於我們的研發活動，包括(i)招募研發人才以增強我們的技術能力。該等研發人員（包括研究員、研發項目經理、測試人員及工程師）將致力於在整個研發過程中持續推動技術進步；及(ii)推進現有及未來研發項目，涵蓋內部及第三方測試費用、原材料採購、能源消耗及其他開支。為滿足高速增長的市場需求（尤其是AI及高性能算力、5G／6G通信以及消費及汽車電子領域），我們將加大對高性能銅箔的資源及人力投入，開發各種抗拉強度等級、表面粗糙度精密可控且電氣性能優異的產品。我們計劃持續開展多個新產品研發項目，主要方向包括：(i)高頻高速電子電路銅箔（HVLP5）及其他先進電子電路銅箔產品；及(ii)合金箔固態電池新型負極集流體材料。

對新研發中心、先進設備、人才引進及貼近市場的研究項目方面的投資，將提升我們動態適應不斷擴展的業務場景及不斷變化的消費者需求的能力。

- 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）將用作營運資金及其他一般公司用途。

若[編纂][編纂]未立即用於上述用途，則在相關法律法規許可的情況下，所得款項淨額將會存入在持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律法規）開立的短期計息賬戶。